

ブース出展のご案内 【JPCA Show 2014 (第44回国際電子回路産業展)】

会期: 2014年6月4日(水) ~ 6月6日(金) 会場: 東京ビッグサイト(東ホール)

【出展概要】

当社はエレクトロニクス産業の未来を見つめ、常にプリント配線板の小型化・高密度化に取り組んでいます。更に高機能化(高剛性・高耐熱・高放熱・高絶縁・大電流)を満足できる最高水準の技術を提供しています。モバイルデジタル機器・車載用途・パワーデバイス・インフラ・航空宇宙から医療・ヘルスケア分野まで、あらゆる電子機器を進化させていきます。

車載プリント配線板 コンセプト

『安全・快適・環境調和』に、高信頼性プリント配線板技術で貢献します！

“心のこもった物づくり”と“品質のCMK”をモットーに車載電子機器におけるプリント配線板で40年以上に渡り世界シェアNO.1を続けております。これからも専門技術チームによる提案でお客様に貢献していきます。

高密度・高機能プリント配線板 コンセプト

『より薄く、より小さく』に、各種最新のプリント配線板技術で貢献します！

モバイル電子機器の小型化、薄型化は益々進んでいきます。これらの要求はもとより、更に一步進んだ高機能化への提案でお客様に貢献していきます。

【出展品目代表例】

1) 車載プリント配線板技術

- パワーデバイス等へ『高放熱・大電流化対応』の提案
- 『セラミックス基板代替・はんだクラック抑制・高耐久性』の提案
- 『コネクタレス・3次元配置で高機能化』の提案
- 新製品開発と問題解決をサポートする『シミュレーション技術』の紹介
- 信頼と実績の『CMK車載用プリント配線板』の紹介



2) 高密度・高機能プリント配線板技術

- 『次世代のモバイル機器に最適』なビルドアップ基板の提案
- 『一步進んだ小型化、薄型化』に貢献するモジュール用基板の提案
- 『放熱性を強化した』モジュール用基板の提案
- 『コネクタレスで薄型化、高機能化』に貢献するリジッド・フレックス基板の提案
- 新製品開発と問題解決をサポートする『シミュレーション技術』の紹介



出展場所: プリント配線板技術展 東5ホール: 5K-04

信頼と実績であらゆる電子機器の進化に貢献して参ります。開催期間中は新技術を中心にプレゼンテーションを実施いたしますので、是非当社ブースへお立ち寄り下さい。

日本シイエムケイ株式会社
JPCAshow2014 運営事務局